

## 2020 年度国家科技进步奖公示内容

项目名称	高性能高密度集成电路封装基板关键技术研发与产业化							
提名单位	深圳市							
提名等级	国家科技进步奖二等奖							
主要完成人情况								
1、第一完成人								
姓名	杨之诚							
完成单位	深南电路股份有限公司							
2、第二完成人								
姓名	刘国平							
完成单位	无锡江南计算技术研究所							
3、第三完成人								
姓名	曹立强							
完成单位	中国科学院微电子研究所							
4、第四完成人								
姓名	蔡坚							
完成单位	清华大学							
5、第五完成人								
姓名	周进群							
完成单位	无锡深南电路有限公司							
6、第六完成人								
姓名	谷新							
完成单位	深南电路股份有限公司							
7、第七完成人								
姓名	刘晓阳							
完成单位	无锡江南计算技术研究所							
8、第八完成人								
姓名	杨智勤							
完成单位	深南电路股份有限公司							
9、第九完成人								
姓名	王谦							
完成单位	清华大学							
10、第十完成人								
姓名	于中尧							
完成单位	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司							
主要完成单位	深南电路股份有限公司、无锡江南计算技术研究所、中国科学院微电子研究所、清华大学、无锡深南电路有限公司、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司							
主要知识产权和标准规范证明目录								
知识产权类别	知识产权具体名称	国家(地区)	授权号	授权日期	证书编号	权利人	发明人	发明专利有效状态
发明专利	一种超薄无芯封装基板的加工方法和	中国	201610864315.X	2019.01.01	3200823	深南电路股份有限公司	郑仰存、李飒、谷新、李俊	有效

发明专利	埋入式线路制作方法和封装	中国	201610864336.1	2019.02.01	3240344	深南电路股份有限公司	李飒、谷新、熊佳、李小新	有效
发明专利	一种铜柱结构封装基板及其加工方法	中国	201510795892.3	2019.07.26	3470965	深南电路股份有限公司	熊佳、谷新、李飒	有效
发明专利	电子元件埋入式电路板及其制造方法	中国	201110228710.6	2013.09.11	1270037	深南电路股份有限公司	谷新、霍如肖、丁鲲鹏、杨之诚、孔令文、蔡	有效
发明专利	PCB基板的封装方法	中国	201110301031.7	2011.09.30	1947850	无锡江南计算技术研究所	梁少文、刘晓阳、吴小龙、吴梅珠、陈文录、孙忠新、	有效
发明专利	真空钎焊方法	中国	201210369488.6	2012.09.28	1503454	无锡江南计算技术研究所	贾建中、刘国平、李建荣、王鸿林、于春涛、	有效
发明专利	一种制作低应力低翘曲度超薄奇数层无芯板的方法	中国	201410246593.X	2017.02.15	2379332	中国科学院微电子研究所、华进半导体封装先导技术研发中心有	于中尧	有效
发明专利	ミリ波導波管通信システム	日本	JP5939657B2	2016.06.22	5939657	中国科学院微电子研究所	曹立强、王启东	有效
发明专利	一种在印刷电路板内植入射频识别RFID信号	中国	201010217096.9	2012.09.05	1034068	清华大学	蔡坚、浦园园、王谦、王水弟、贾松良	有效
发明专利	POP封装结构及其封装方法	中国	201410034040.8	2018.04.20	2891639	清华大学	陈瑜、蔡坚、王谦	有效